

Butterfly 精密加工製作與氣密封裝之開發計畫

計畫目標

以精密加工之基礎，跨足高科技零組件與傳統產業中之關鍵性組件，以期於台灣永續經營。

執行成果

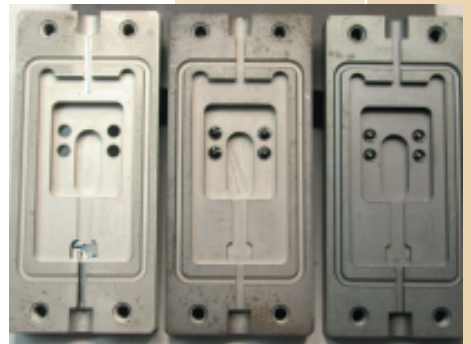
1. 初期目標：以小量試產予國內封裝廠---降低風險。藉由小量試產累積經驗，以免冒然量產，產生過多不良品，造成浪費。
2. 中期目標：產品技術穩定，以提供予國內光通訊廠商。
3. 長期目標：供應予全球各地市場。

新產品 / 新技術 / 新設計 / 新材料簡介

關鍵技術 / 零組件	材料來源
Butterfly housing精密加工	1. KOVAR由國外購買
1. KOVAR精密加工技術	2. 玻璃、金屬材料由國外購買
2. 金屬與玻璃燒結技術	
3. 金屬表面鍍鎳金技術	

技術合作單位及合作內容

1. 財團法人工業技術研究院- Butterfly housing氣密封裝
2. 臻龍實業股份有限公司-金屬與玻璃封裝之爐具作業



■ 成果應用領域

應用範圍	可應用之元件
光通訊	主動元件：光收/發模組元件 被動元件：光開關，可調式光衰減器，波長鎖定器
無線通訊	R F 收/發模組元件
感測元件	MEMS 產品：汽車安全氣囊感測器，胎壓器感測器

■ 專案執行重要心得

暘升以精密機械加工的技术為國內幾家無線通訊及光通訊的廠商代工，另外也為美國光通訊大廠E-TEK光開關的housing及JDSU公司之WAVE LENGTH LOCKER之housing與submount代工，證明暘升在精密機械加工方面的技術已受到國外的肯定，以達到國際的標準。目前暘升將精密機械加工技術應用在butterfly housing之製作，將開發之butterfly housing 提供給工研院光電所應用在1'2光開關元件的封裝，此項商品若能符合封裝規格的要求將使得暘升往光電產業封裝零組件的市場邁進一大步，並開創暘升在光通訊butterfly housing 氣密封裝的市場，進而提昇光電封裝的精密度及品質，有效促進產業升級及轉型為尖端科技研發的重要夥伴。

